

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

## 龙芯中科技术股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	东兴证券、海通证券、华福证券、黄河财险、上海石丸梨花私募、新沃基金、兴合基金
时间	2024年12月12日
地点	北京市海淀区中关村环保科技示范园龙芯产业园2号楼
上市公司接待人员	证券事务代表-李琳
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、我们的IP核能对外授权吗？</b></p> <p>龙芯有自主研发的优势，拥有自主指令架构和自主IP，可以开展对外技术授权。龙芯开展IP授权业务主要是为了做生态的需要。在2023年11月龙芯3A6000的发布会上，多家企业与龙芯签署合作协议，使用基于龙架构的IP核设计芯片。目前已经有两家企业推出龙架构的芯片在售，有三所高校推出龙架构芯片。</p> <p>IP授权业务的营收是按领域计入工控或信息化芯片营收的，目前体量还比较小，业务的规模化发展还尚需一定时间。理想的状态是未来有更多的企业，推出龙架构芯片，生态逐步发展起来。</p> <p><b>2、龙芯近期新产品的研发进展？</b></p> <p>桌面CPU，龙芯目前展开的下一代桌面芯片3B6600的研制，8核桌面CPU，集成GPGPU及PCIE接口。与前款芯片相比，工艺不变，结构优化。3B6600目前处于设计阶段，预计明年</p>

上半年交付流片。

服务器 CPU，公司下一代服务器芯片 3C6000 目前处于样片阶段，预计 2025 年 Q2 完成产品化并正式发布。根据我们内部自测的结果，16 核 32 线程的 3C6000/S 性能可对标至强 4314，双硅片封装的 32 核 64 线程的 3D6000（3C6000/D）可对标至强 6338，四硅片封装 60/64 核 120/128 线程的 3E6000（3C6000/Q）已在今年 11 月份封装回来，在测试过程中。

GPGPU 芯片，目前在研的首款 GPGPU 芯片 9A1000 定位为入门级显卡以及终端的 AI 推理加速（32TOP），显卡性能对标 AMD RX550，预计 2024 年底代码冻结，争取明年上半年流片。

### **3、龙芯产品性价比优势怎么理解？**

2022 年-2024 年三年研发转型，我们的重点关注提升产品性价比和软件生态。龙芯以“三剑客”和“三尖兵”为代表的第四代产品具有很高的性价比，比如“三剑客”3A6000 是面向桌面市场的芯片，相较于 3A5000 硅面积减小了 20%，单核性能提高 60%，多核性能提高 100%，今年以来已得到市场检验；3C6000 是面向服务器市场的芯片，与 3C5000 相比性能提升一倍，成本减半，处于样片阶段；定位终端的 2K3000，8 核终端 SoC，核数翻倍，成本减半，已交付流片。

龙芯坚持自主研发，拥有自主指令架构 LA，关键核心 IP 也都是自研，不涉及授权费用，长期看是有成本优势以及技术快速迭代优势的。再加上龙芯自主研发的 GPU、桥片、电源、时钟等配套芯片，系统成本优势将更加凸显。龙芯正在将自主研发的优势转化为性价比的优势，而且我们认为性价比还有持续提升的空间。